

AUTRES PRODUITS

• MATÉRIAUX D'ENCAPSULATION À POLYMÉRISATION EN PLACE

Ces composés à modelage en place déposés conçus pour dissiper la chaleur sans force de compression excessive dans des applications de refroidissement électronique. Ils remplacent avantageusement les feuilles moulées quand ils sont utilisés par exemple pour le refroidissement des composants de différentes hauteurs qui se trouvent sur les cartes de circuit imprimé. Chaque composé est disponible dans des cartouches prêtes à l'emploi, ce qui permet d'éliminer les étapes de pesée, mélange et dégazage.

Caractéristiques et avantages :

- Remplissage d'espace, enrobage étanchéité et encapsulation
- Excellente conductivité thermique élevée, flexibilité et facilité d'utilisation
- S'adaptent aux formes irrégulières sans appliquer de force excessive sur les composants
- Système de cartouche prêt à l'emploi éliminant les étapes de pesée, mélange et dégazage
- Plusieurs tailles et configurations de kits disponibles pour convenir à toute application (cartouches double-corps manuelles et applicateurs pneumatiques)

| MATERIAUX D'ENCAPSULAGE A POLYMERISATION EN PLACE | | |
|--|---|----------------------|
| Propriétés standard | T647 | 1641 |
| Couleur | Gris | Blanc |
| Liant | Silicone | Silicone |
| Charge | Oxyde d'aluminium | Oxyde d'aluminium |
| Nombre de composants | 2 | 1 |
| Rapport de mélange | 1 : 1 | ND |
| Poids spécifique | 2.8 | 2.10 |
| Dureté, Shore A | 25 | 78 |
| Viscosité, en poisse | >5 000 | 3 000 |
| Vie en pot, en minutes | 300 | 30 |
| Cycles de polymérisation | 3 min à 150°C 60 min. à 60°C 48h à 23°C | 48h à 23°C |
| Temps limite de non-fragilité, °C | -55 | -75 |
| Silicone extractible, % | 4 | Non testé |
| Capacité thermique, J/g.K | 3.00 | 0.90 |
| Conductivité thermique apparente, W/m.K | 0.9 | 1.0 |
| Coefficient de dilatation thermique, ppm/K | 150 | 150 |
| Plage de température de fonctionnement | -50 à 150 | -70 à 200 |
| Force diélectrique | 10 | 20 |
| Résistivité volumique Ohm.cm | 1.0×10^{14} | 1.0×10^{13} |
| Constante diélectrique à 1 000 kHz | 8 | 3.9 |
| Coefficient de dissipation à 1 000 kHz | 0.010 | 0.010 |
| Indice d'inflammabilité | Non testé | Non testé |
| Conforme aux spécifications RoHS | Oui | Oui |
| Dégazage % TML | Non testé | Non testé |
| Durée limite de stockage, en mois à partir de la date d'expédition | 3 | 6 |

1641 : - Mono-composant type RTV
- Sans dégagement d'acide acétique

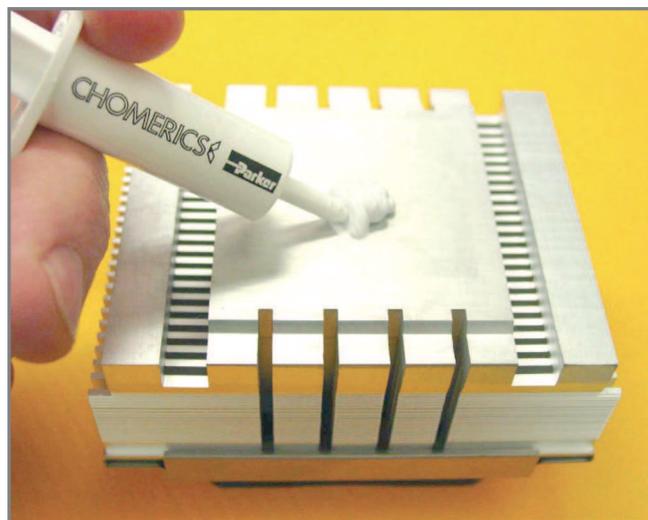
T647 : - Coule dans des géométries complexes afin de maintenir un contact rapproché avec les composants.
- Excellentes performances thermiques et module faible

• GRAISSES ET GELS THERMIQUES

Ces graisses thermiques sont des matières sérigraphiées, ou distribuées et ne nécessitent pratiquement aucune force de compression pour s'adapter sous des pressions d'assemblage standard. Leur excellent mouillage de surface permet une faible résistance interfaciale.

Caractéristiques et avantages :

- Matières à base de silicone conduisant la chaleur entre un composant chaud et un radiateur ou un boîtier
- Pour remplir l'espace inégal qui existe entre les composants électroniques et les radiateurs
- Matières à déposer et hautement adaptables, ne nécessitant ni cycle de polymérisation ni mélange, ni réfrigération
- Thermiquement stables et ne nécessitant pratiquement aucune force de compression pour se déformer sous des pressions d'assemblage standard
- Pour des applications haute puissance nécessitant un produit ayant une épaisseur de plan de joint minimum et une conductivité élevée
- Parfaits pour le réusinage et les réparations sur le terrain



| GRAISSES ET GELS THERMIQUES | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Propriétés standard | T650 | T670 |
| Couleur | Bleu | Blanc |
| Poids spécifique | 2.3 | 2.6 |
| Viscosité, cP | 190 000 | 350 000 |
| Plage de températures de fonctionnement, °C | -50 à +200 | -50 à +200 |
| Point de fusion, °C | ND | ND |
| Perte de poids, % à 150 °C, 48 heures | 0.21 | <0.2 |
| Impédance thermique, °C.cm ² /W à 10 psi | 0.13 à 50 °C 0.13 à 65 °C | 0.07 à 50 °C 0.07 à 65 °C |
| Conductivité thermique apparente, W/mK | 0.8 | 3.0 |
| Capacité thermique, J/g.K | 1 | 1 |
| Coefficient de dilatation thermique, ppm/K | 300 | 150 |
| Résistivité volumique, Ohm.cm | 10 ¹⁴ | 10 ¹⁴ |
| Décomposition des tensions, Vca/mil | 150* | 150* |
| Indice d'inflammabilité | Non testé | Non testé |
| Conforme aux spécifications RoHS | Oui | Oui |
| Dégazage, % TML | 0.21 | <0.2 |
| Durée limite de stockage, en mois à partir de la date de fabrication | 24 | 24 |

* Non recommandé pour les applications diélectriques

T650 : - Utilisée pour des applications standard

T670 : - Conductivité thermique totale élevée

- Impédance thermique extrêmement faible à des épaisseurs de plan de joints fines et épaisses
- Tirage au stencil ou sérigraphie